

深圳市德普微电子有限公司

Developer Microelectronics Co;Ltd

深圳市福田区新亚洲电子城二期国利大厦 2218, 2220

Tel: (86)755-83047956 Fax: (86)755-83047953

<http://www.depuw.com>



表格编码: DP-YW-BJ-01

集成电路使用常识

-----参考 IPC/JEDECJ-STD-020C

1. 避免产品使用或运输过程中的静电损伤。
2. 普通塑封料封装，耐回流焊的温度 $245+0/-5^{\circ}\text{C}$ 。
3. 环保塑封料封装，耐回流焊的温度 $260+0/-5^{\circ}\text{C}$ 。
4. 产品储存环境条件为温度 $22\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 30%RH~60%RH，且最好增加除湿器，储存时间为 6 个月。
5. 产品在密封袋开封使用时，采用红外回流、气相回流、波峰焊或等效处理工艺，必须按照以下条件进行：
 - A. 工厂环境温度 $<30^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<45\%\text{RH}$ 时，72 小时内安装。
 - B. 在温度 $22^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<30\%\text{RH}$ 的环境下储存，储存时间不能超过 72 小时。
 - C. 超出上述条件，在安装前必须进行烘烤（ 125°C ，24 小时）
 - D. 同一产品最多只能烘烤 3 次（无氧化烘烤）